

DOCBOND 底部填充胶

产品名称	DOCBOND 底部填充胶
公司名称	惠州市杜科新材料有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:DOCBOND 规格:30ml/50ml
公司地址	惠州大亚湾科技创业服务中心孵化楼B栋6楼
联系电话	7525587120 18927329853

产品详情

本系列产品为单组份环氧密封、低卤素底部填充胶。常用于CSP或BGA底部填充制程。可形成一致和无缺陷的底部填充层，可有效降低由于硅芯片与基板间的总体温度膨胀和不匹配或外力造成的冲击。